SIM8200G

ソフトバンクネットワーク対応の通信方式 5GNR(Sub-6GHz)/LTE通信モジュール、SIM8200Gのご紹介です。

SIM8200G

SIMCOM社製

5 G NR(Sub6GHz)/ LTE
通信モジュール

(LGA Type)

特長

- Softbank 5G NR(Sub-6GHz)及び LTE Advanced (Cat.15)対応
- パケット通信対応/SMS対応
- GPS/GLONASS/BEIDOU/Galileo/QZSS
- 海外バンド対応

スペック

製品名	SIM8200G ※ソフトバンク対応のハードウェア：SIM8200G(R2)
サイズ	41 x 44 x 2.8 [mm]（H×W×D）
重量	約11 g
通信方式	5G/FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA
周波数	5G: n3/n28/n77 FDD-LTE: B1/B3/B8/B28 TDD-LTE: B41/B42 海外Band(5G): n1/n2/n5/n7/n8/12/n20/n25/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n78/n79 海外Band(FDD-LTE):B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B29/ B30/B32/B66/B71 海外Band(TDD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41/B43/B48
電源電圧	DC 3.3~4.4 V
消費電流	通信時：850 (最大) mA 待機時：3 mA (sleep)
外部インターフェース	USB2.0/USB3.1/UART/ USIM/PCM/SPI/ADC/I2C/ GPIO/RGMII/PCIe3.0/ SDIO3.0/PMI
制御コマンド	ATコマンド
動作環境	動作温度：-40～85°C (extended operation) 保存温度：-40～90°C
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品はSIMCOM社製造、キャセイ・トライテック株式会社より販売します

▶ 詳細は製品メーカWebサイトへ

http://www.cathay.jp

※パンフレットの記載内容は、2023年3月10日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら
https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。